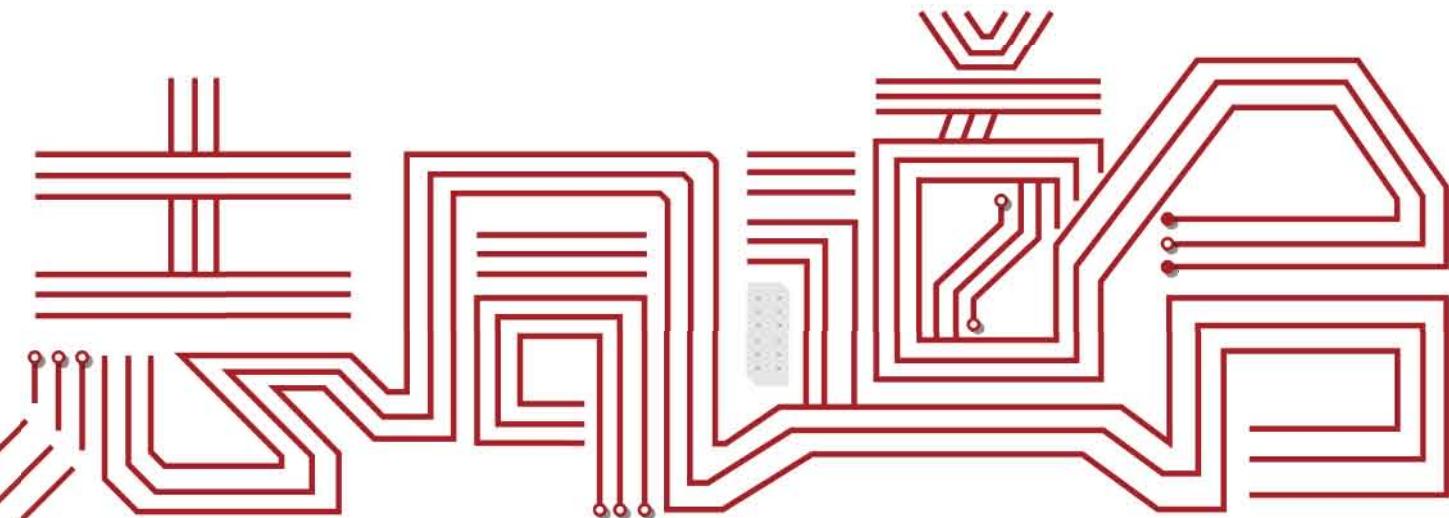




台灣積體電路製造股份有限公司
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.

SUMMER INTERNSHIP PROGRAM



2018 實習計畫

Pave Your Path for Future Career

想更認識台積嗎？你可以再靠近一點！

實習期間將被分派與所學領域相關的專案，
提早體驗職場並與台積團隊進一步互動學習。

履歷收件倒數中，
申請時間至 **4/9(一)** 截止～
利用清明連假線上填寫履歷，
把握提早體驗職場的機會

實習領域

科技領域

研究與發展、IC設計、營運製造、品質與可靠性等。

專業領域

資訊相關、人力資源、財務、法務、企業規劃等。



申請資格

實習期間需具備學生身分，在學學生皆可申請，碩博士將優先晉用。

申請時間

即日起至2018年4月9日



實習履歷投遞

goo.gl/NtNfZ1